



特徴

LCD基板上に印刷された塗膜を基板裏面(反塗布面側)により加熱することで、ガラス基板を加熱乾燥させる乾燥機。
 9分割制御方式のため、基板上の温度管理を均一にできる。
 乾燥時に起きる、ピンムラ対策として、Φ1mmのワイヤーで基板受け渡しを行う。
 ワイヤー位置は、ステッピングモータを使用(8ユニット)
 パターン外の位置に設定を行うことで、パターン内の乾燥ムラを防止する。

使用内容

9分割温度制御
 温度性能 室温~200℃(プレート上)
 出力 2200W×9回路 19.8Kw
 電力 三相200V 50/60HZ
 使用用途
 半導体製造装置 FPD製造装置関連

